

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

平2-86128

⑤ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)7月9日

H 01 L 21/304
B 24 B 37/043 2 1 E
Z8831-5F
7726-3C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑭ 考案の名称 ウエハ用研磨機における研磨検査装置

⑯ 実 願 昭63-166251

⑰ 出 願 昭63(1988)12月21日

⑱ 考 案 者 安 芸 康 夫

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内

⑲ 出 願 人 ローム株式会社

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

⑳ 代 理 人 弁理士 石井 暁夫

㉑ 実用新案登録請求の範囲

上面に研磨クロスを張設した固定定盤と、該固定定盤における研磨クロスにウエハを回転しながら押圧するホルダーとから成るウエハ研磨装置において、前記固定定盤及び研磨クロスに、前記ウエハにおける研磨表面にのぞむ検査孔を穿設し、この検査孔内に、前記ウエハにおける研磨表面に対して光を照射するための投光用光ファイバーと、前記ウエハにおける研磨表面からの反射光を受光するための受光用光ファイバーとを挿入した

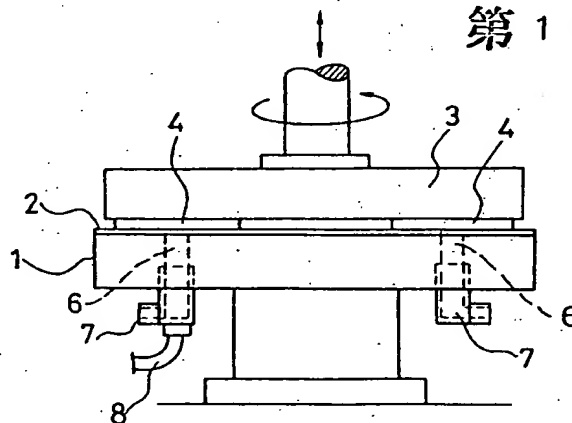
ことを特徴とするウエハ用研磨機における研磨検査装置。

図面の簡単な説明

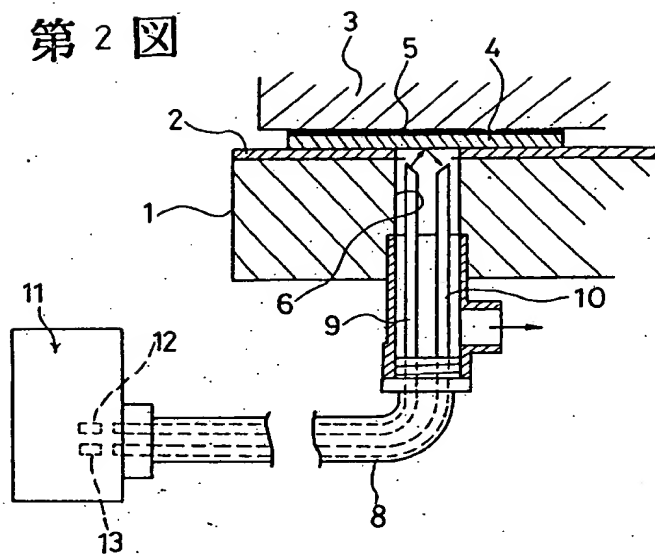
図面は本考案の実施例を示し、第1図は正面図、第2図は第1図の要部拡大断面図である。

1……固定定盤、2……研磨クロス、3……ホルダー、4……ウエハ、6……ドレイン孔、8……検査用ケーブル、9……投光用光ファイバー、10……受光用光ファイバー、11……検査回路、12……発光素子、13……受光素子。

第1図



第 2 図



Utility Model Application No. S63-166251

(57) Claim

A wafer polishing machine comprising a fixed surface plate provided on an upper face thereof with a polishing (abrasive) cloth in a spanning manner and a holder which presses a wafer onto the polishing cloth while rotating the polishing cloth, wherein an inspection hole facing a surface of the wafer to be polished is bored in the fixed surface plate and the polishing cloth, and a light emitting optical fiber for irradiating light to the surface of the wafer to be polished and a light receiving fiber for receiving reflected light from the surface of the wafer to be polished are inserted into the inspection hole.

Brief Description of the Drawings

Drawings show an embodiment of the present invention, where Fig. 1 is a front view and Fig. 2 is an enlarged sectional view of a main portion in Fig. 1.

1...fixed surface plate; 2...polishing cloth; 3...holder; 4...wafer; 6...drain hole; 8...inspection cable; 9...light emitting fiber; 10...light receiving fiber; 11...inspection circuit; 12...light emitting element; and 13 light receiving element.